

## 平成 13 年度事業計画書

(自：平成 13 年 4 月 至：平成 14 年 3 月)

### 1. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催 (定款第 4 条第 1 号関係)

- (1) IEEE CPMT Japan Chapter と共催で、第 5 回目の国際会議「2001 ICEP (旧 IEMT / IMC Symposium)」(2001.4.18~20)開催(次回予定：2002.4.17~19,開催地：東京流通センターR'n ホール予定)
- (2) 第 15 回マイクロエレクトロニクスショー(2001.4.18~20)は「最先端実装技術・パッケージ展」を前面に開催(次回予定：2002.4.17~19,開催地：東京流通センターE・F ホール予定)
- (3) 「第 16 回エレクトロニクス実装学術講演大会」(2002.3.18~20,於：神奈川大学)開催
- (4) 先端技術セミナーの開催
  - ・ JPCA ショー特別セミナー(2001.6.6~7)
  - ・ 定例セミナー(2001.10 と 2002.1)
- (5) 「第 11 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム」(2001.10.18~19,於：大阪大学コンベンションセンター)開催
- (6) 地域交流の促進

### 2. 調査・研究活動 (定款第 4 条第 2 号関係)

- (1) 技術運営委員会とその下にある 13 分野の技術委員会(材料/回路・実装設計/電磁特性/配線板製造/信頼性解析/装置/電子部品・実装/検査/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロ・メカトロニクス実装/電子 SI)において、実装技術に関する技術的な諸課題と今後の動向を調査研究するため、研究討論会、ワークショップ、シンポジウム等を開催。
- (2) エレクトロニクス実装技術の分析・調査
- (3) 低温鉛フリーはんだ実装技術開発プロジェクトの推進

### 3. 普及啓発活動 (定款第 4 条第 3 号関係)

学会賞の授与、技術講習会・入門講座・技能検定試験講習会等の教育事業活動の充実。

- (1) 「エレクトロニクス実装学会賞」等の授与
- (2) 「エレクトロニクス実装技術総合講座」
- (3) 「実装技術入門講座」
- (4) 「プリント配線板製造技術講座(入門編&中級編)」
- (5) 「技能検定設計実技講習会」

### 4. 情報収集及び提供活動 (定款第 4 条第 4 号関係)

- (1) 「エレクトロニクス実装学会誌」の発行
  - 会員の日常の技術・研究活動の成果として発表される研究論文、技術論文、速報論文、解説等を学会誌に掲載し、エレクトロニクス実装の技術と研究に関する最新の情報を収集・提供する。
- (2) 「プリント配線板技能検定受検者用テキスト」の発行
- (3) 各種技術委員会・研究会の成果のテキスト発行
- (4) 海外関係団体出版物の頒布、海外情報の提供

**5．内外機関等との交流・協力活動（定款第4条第5号関係）**

- (1) IMAPS との連携発展
- (2) 海外の国際会議の開催に協力・会員の参加への支援
- (3) 日韓共同実装技術セミナー開催
- (4) エコデザイン学会連合との連携
- (5) シンガポールセミナー開催
- (6) 電子SI 連絡協議会との連携